

Title (en)

Device and method for coating a even substrate

Title (de)

Vorrichtung und Verfahren zum Beschichten eines ebenen Substrates

Title (fr)

Dispositif et procédé de revêtement d'un substrat plan

Publication

**EP 1010473 A2 20000621 (DE)**

Application

**EP 99811153 A 19991213**

Priority

CH 249698 A 19981217

Abstract (en)

The arrangement has a coating module (2) with a capillary column filled with a liquid coating medium and with an opening past which the surface to be coated is moved at a relatively small distance so that a coating is deposited onto the surface. The capillary column is open at the bottom and is filled with coating medium via a supply chamber (25,27). The substrate (23) is passed beneath the opening of the column with the surface (23a) to be coated facing upwards. An Independent claim is also included for a method of coating a flat substrate.

Abstract (de)

Die Vorrichtung weist ein Beschichtungsmodul mit einem Kapillarspalt (8) auf. Der Kapillarspalt (8) ist mit einem flüssigen Beschichtungsmedium (28) gefüllt und weist eine Öffnung (9) auf. Eine zu beschichtende Oberfläche (23a) des Substrates (23) ist in vergleichsweise kleinem Abstand am Kapillarspalt (8) vorbeizuführen, so dass sich eine Schicht (43) auf der genannten Oberfläche (23a) abscheidet. Der Kapillarspalt (8) ist unten offen und über einen Versorgungsraum (25, 27) mit Beschichtungsmedium (28a) gefüllt. Das Substrat (23) wird unter der Öffnung (9) des Kapillarspaltes (8) mit der zu beschichtenden Oberfläche (23a) nach oben vorbeigeführt. Mittels einer Zuführvorrichtung (25) wird dem Kapillarspalt (28) über eine Öffnung (11) des Beschichtungsmoduls (2) Beschichtungsmittel (28) nachlieferbar. Die Vorrichtung ermöglicht eine hohe Beschichtungsgeschwindigkeit bei geringerem Lackverbrauch. <IMAGE>

IPC 1-7

**B05C 5/02**

IPC 8 full level

**B05C 5/02** (2006.01); **B05C 9/02** (2006.01); **B05C 11/10** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B05C 5/0254** (2013.01 - EP US); **B05C 9/02** (2013.01 - EP US); **B05C 11/1013** (2013.01 - EP US); **Y10S 118/04** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)

US 5650196 A 19970722 - MUEHLFRIEDEL EBERHAR [DE], et al

Designated contracting state (EPC)

DE ES FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

**EP 1010473 A2 20000621**; **EP 1010473 A3 20030528**; **EP 1010473 B1 20060712**; CA 2292271 A1 20000617; CA 2292271 C 20080318; DE 59913661 D1 20060824; ES 2274611 T3 20070516; MX PA99011776 A 20050419; US 6383571 B1 20020507

DOCDB simple family (application)

**EP 99811153 A 19991213**; CA 2292271 A 19991216; DE 59913661 T 19991213; ES 99811153 T 19991213; MX 9911776 A 19991215; US 46658499 A 19991217